

平成 27 年 12 月 24 日

セイコーインスツル株式会社の 産業競争力強化法に基づく事業再編計画を認定しました

経済産業省は、本日、産業競争力強化法第 24 条第 1 項の規定に基づきセイコーインスツル株式会社から提出された「事業再編計画」を認定しました。
当該計画は、セイコーインスツル株式会社及び株式会社日本政策投資銀行が、エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社に出資し、セイコーインスツル株式会社が、半導体事業を会社分割により、エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社へ譲り渡すものです。
当計画を通じて、半導体事業の円滑な経営及び事業体制を確立し、あわせてグローバルに市場拡大が見込まれるこの分野で販路拡大に資する取組を実施することにより、半導体事業においてグローバル・プレゼンスを有する事業体を目指します。

1. 事業再編計画の認定

セイコーインスツル株式会社から提出された「事業再編計画」について、産業競争力強化法第 24 条第 1 項の規定に基づき審査した結果、同法第 2 条第 11 項に規定する事業再編を行うものとして、同法で定める認定要件を満たすと認められるため、「事業再編計画」の認定を行いました。

今回の認定により、セイコーインスツル株式会社は第三者割当増資による資本金の増加に係る登録免許税の軽減措置を希望しております。

2. 事業再編計画の実施時期

開始時期 平成 28 年 1 月 ～ 終了時期 平成 30 年 3 月

3. 申請者の概要

名 称:セイコーインスツル株式会社
代 表 者:代表取締役 村上 斉
本社所在地:千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 8 番地

(参考)法律・関連した支援制度の詳細は下記特設 URL をご覧ください。

http://www.meti.go.jp/policy/jigyousaisei/kyousouryoku_kyouka/index.html

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務情報政策局デバイス産業戦略室長 田中

担当者:小泉、清野

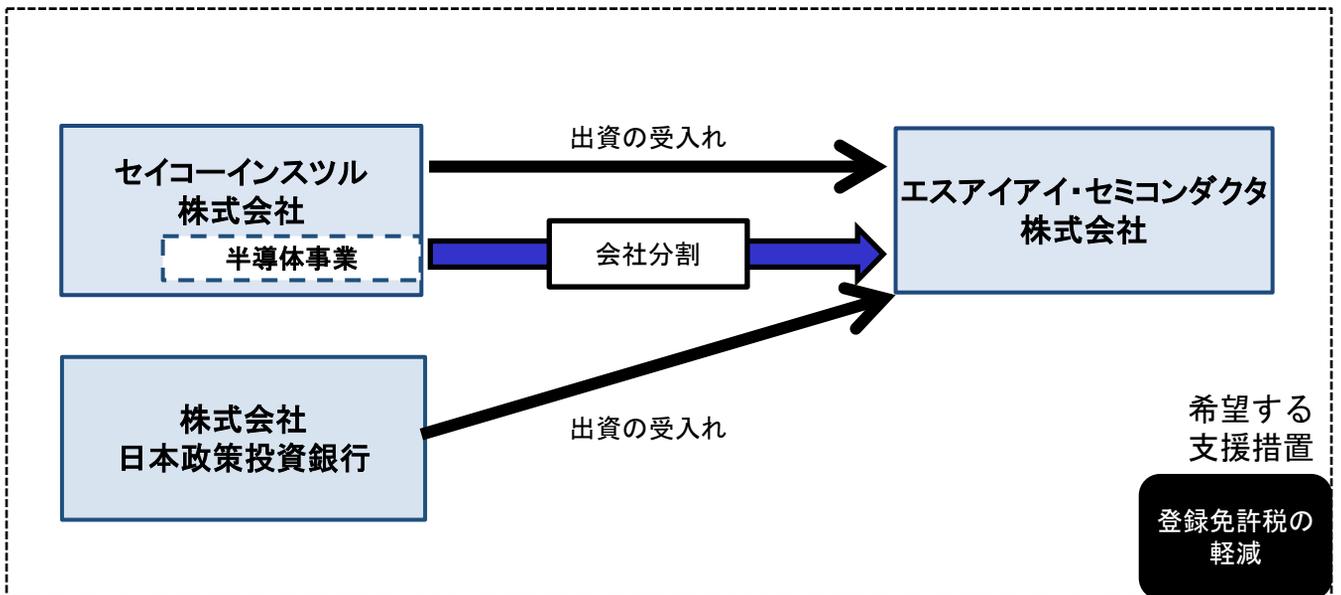
電 話:03-3501-1511(内線 3981)

03-3501-6944(直通)

セイコーインスツル株式会社の「事業再編計画」のポイント

セイコーインスツル株式会社及び株式会社日本政策投資銀行は、エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社に出資し、セイコーインスツル株式会社は、半導体事業を会社分割により、エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社へ譲り渡す。

当計画を通じて、半導体事業の円滑な経営及び事業体制を確立し、あわせてグローバルに市場拡大が見込まれるこの分野で販路拡大に資する取組を実施することにより、半導体事業においてグローバル・プレゼンスを有する事業体を目指す。



【生産性の向上】

・従業員一人当たりの付加価値額を平成30年3月までに8%向上させる。

【財務の健全性】

・有利子負債/キャッシュフロー 2倍
 ・経常収支比率 104.7%

【新商品の開発】

・新商品の売上高を計画最終年度(平成29年度)において、総売上高比 1.8%以上とする。

【計画の実施期間】

・平成28年1月～平成30年3月

様式第十八（第13条関係）

認定事業再編計画の内容の公表

1. 認定をした年月日
平成27年12月24日

2. 認定事業者名
セイコーインスツル株式会社

3. 認定事業再編計画の目標

（1）事業再編に係る事業の目標

当社の半導体事業は、時計製造で培った低消費電流・低電圧動作・超小型パッケージ化技術などを活かし、国内トップシェアを誇る車載用EEPROMや、スマートフォンやタブレットなど小型携帯端末のパワーマネジメントに欠かすことのない電源ICなど、優れた半導体製品を提供している。

半導体事業は、その高い収益性ととともに、グローバル・トップクラスの技術・人材・知的財産・顧客基盤等の経営資源や市場での競争ポジションを最大限に活かすことにより、更なる成長が期待できる事業である。

今後、グローバルでの競争激化が進む半導体市場での持続的な成長のため、このたび、当社と株式会社日本政策投資銀行（以下、DBJ）は、当社の半導体事業を両社の共同出資による半導体事業の新会社へ移管する契約を締結した。

新会社は、製造能力拡大・開発機能強化を図りながら、M&Aやアライアンス等を含めた業界再編を成長戦略の中核として推進し、半導体業界においてグローバル・プレゼンスを有する事業体（アナログ半導体を中心とした対象事業の主力分野では、世界トップ5位以内）となることを目指す。

（2）生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標

計画の対象となる事業の生産性の向上としては、平成29年度には平成26年度に比べて、従業員1人当たりの付加価値を8%向上させることを目標とする。

財務内容の健全性の向上としては、平成29年度において、有利子負債キャッシュフロー2倍、経常収支比率は104.7%となる予定である。

4. 認定事業再編計画に係る事業再編の内容

（1）事業再編に係る事業の内容

①計画の対象となる事業

対象事業は当社の半導体事業部門であり、電源用ICを中心とするアナログIC、EEPROMと呼ばれるメモリ及びセンサ等を中心とした半導体の開発・製造・販売を行っている。これら半導体製品の使用用途は民生機器用と車載向けに大別され、特に対象事業が扱う製品は汎用性の高い商品であることが特徴である。

<選定理由>

当社が手掛ける半導体の関連市場は、スマホ・タブレット等の電子デバイス製品市場の拡大や、自動車の電装化進展等を受けて安定成長を続けており、将来的にもIoTの進展等によりグローバル市場の更なる拡大が見込まれている。斯業界において、当社半導体事業は、時計製造で培った小型・省電力技術をベースに、EEPROMや電源ICなどのアナログ半導体をはじめとする優れた製品を継続的に提供し、高い収益性を保持してきた優れた事業である。また、これまで築いてきた顧客基盤や開発・製造に係る技術力等、今ある競争ポジションを最大限に活かせば、更なる成長が期待できる事業である。また今般、当社半導体事業の戦略的パートナーとしてDBJの資本を受け入れることで、成長投資資金の効率的な活用・調達を行える可能性が高まり、広範囲な取引先を有するDBJのネットワーク等を活かした他者とのアライアンス等も含め、成長のための戦略オプションが大きく広がることが期待されている。

②実施する事業の構造の変更と分野又は方式の変更の内容

半導体事業の新会社株式を、当初、当社が60%持分を、DBJが40%持分を保持し、両社が協議して新会社の運営を行い、前述の成長戦略を進める予定である。

当社が継続して新会社の一定持分を保持することで、半導体事業の円滑な経営・事業体制を確立し、DBJとの取り組みにより新会社の成長と収益の拡大を図り、当社及びセイコーホールディングス株式会社グループ全体の中長期的な企業価値向上に貢献することを目指す。

なお、当該事業再編計画による生産性の向上は当該事業分野における市場構造に照らしても継続的なものと見込まれる。

また、当該事業分野は過剰供給構造にはなく、さらに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害する恐れがあるものではない。

(事業の構造の変更)

・出資の受入れ

エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社はセイコーインスツル株式会社及び株式会社日本政策投資銀行を引受先とする第三者割当増資を実施する。

増資額：18,480,000,000円（うち9,240,000,000円を資本金へ組入れ）

増資前の資本金額：10,000,000円

増資後の資本金額：9,250,000,000円

増資の方法：第三者割当増資

増資予定日：平成28年1月4日

発行する株式を引き受ける者：セイコーインスツル株式会社、
株式会社日本政策投資銀行

・半導体事業の会社分割（分社型吸収分割）

〈分割会社〉

名称：セイコーインスツル株式会社

住所：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地

代表者の氏名：代表取締役 村上 斉

資本金：9,756,000,000円

〈承継会社〉

名称：エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社

住所：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地

代表者の氏名：代表取締役 下田 貞之

分割前の資本金額：9,250,000,000円

分割後の資本金額：9,250,000,000円

(2) 事業再編を行う場所の住所

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地

セイコーインスツル株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地

エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社

(3) 関係事業者・外国関係法人に関する事項

エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社

セイコーインスツル株式会社が発行済株式総数の100%を保有しており、関係事業者に該当する。なお、会社分割及び第三者割当増資の実施後も60%を保有することとなり、引き続き関係事業者となる。

(4) 事業再編を実施するための措置の内容

別表1のとおり

5. 事業再編の開始時期及び終了時期

開始時期：平成28年1月

終了時期：平成30年3月

6. 事業再編に伴う労務に関する事項

(1) 事業再編の開始時期の従業員数（平成28年1月末時点）

セイコーインスツル株式会社 1,781名

エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社 772名

(2) 事業再編の終了時期の従業員数（平成30年3月期時点）

セイコーインスツル株式会社 1,455名

エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社 790名

(3) 事業再編に充てる予定の従業員数

セイコーインスツル株式会社 0名

エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社 790名

(4) (3) 中、新規に採用される従業員数

セイコーインスツル株式会社 0名

エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社 30名

(5) 事業再編に伴い出向または解雇される従業員数

出向・転籍予定人数 772名

※分割時は出向扱いとし、出向者は分割後2年を目途に転籍予定

解雇予定人数 0名

7. その他

該当なし

別表 1

事業再編の措置の内容

措置事項	実施する措置の内容及びその実施する時期	期待する支援措置
法第2条第11項第1号の要件		
ロ 会社の分割	<p>〈分割会社〉 名称：セイコーインスツル株式会社 住所：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地 代表者の氏名：代表取締役 村上 斉 資本金：9,756,000,000円</p> <p>〈承継会社〉 名称：エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社 住所：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地 代表者の氏名：代表取締役 下田 貞之 分割後の資本金：9,250,000,000円</p>	該当なし
へ 出資の受入れ	<p>エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社はセイコーインスツル株式会社及び株式会社日本政策投資銀行を引受先とする第三者割当増資を実施</p> <p>増加前資本金 : 10,000,000円 増加する資本金 : 9,240,000,000円 増資の方法 : 第三者割当増資 増資予定日 : 平成28年1月4日</p>	租税特別措置法第80条第1項第1号（認定事業再編計画等）に基づき行う登記の軽減
法第2条第11項第2号の要件		
イ 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供による生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成の変化	<p>車載用のECU（電子制御ユニット）向けに小型高精度・高耐圧・低消費電流のアナログ半導体の製造販売を行い、平成29年度には当該新商品の売上高をエスアイアイ・セミコンダクタの全売上高の1.8%以上とすることを目標とする。</p>	